东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

（2026 年 11 月 10 日）

证券代码：688110　　证券简称：东芯股份

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研　☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访　☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会　☑ 路演活动 ☐ 现场参观　☐ 电话会议 ☑ 其他（策略会）
参与单位名称	ACG Management、Dymon、ExodusPoint Capital Management、Mawer Investment Management、Point72 Asset Management、UBP Shanghai、大家资产、东方证券自营、冯源资本、航长投资、杭银理财、华安基金、华宝信托、华能贵诚信托、华源资管、汇添富基金、火线资产、宽源投资、国开资管、国寿资产、摩根士丹利基金、宁波量利投资、诺安基金、源峰基金、迎水投资、银华基金、信泰人寿、新华养老、煜德投资、中移资本、中信资管、中信自营
活动时间	2026 年 11 月 3 日、11 月 4 日、11 月 5 日、11 月 6 日
活动地点	策略会、反路演
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 证券事务代表：黄沈幪 投资者关系：唐超宇、杨丽颖
投资者关系活动主要内容介绍	**1：今年以来客户结构有什么变化？** 答：公司客户主要分为网络通信、监控安防、消费电子、工业控制和汽车电子五大类。不同下游领域的需求受行业周期、产品价格及客户供应链策略等因素影响，表现有所差异。总体来说，消费电子类客户对产品价格的敏感度相对较高；工业控制、车规类客户则更加关注产品生命周期、供货稳定性及品质一致性，加之海外原厂加速退出利基市场对其供应链的影响较为明显，因此相关需求受存储产品价格波动影响相对有限。公司将持续关注各领域客户需求变化，稳步推进产品导入与市场拓展。感谢您对公司的关注。 **2：如何判断后续的竞争格局？是否会因为高毛利而出现新进入者？** 答：尊敬的投资者，您好！关于竞争格局，当前利基型存储的结构性紧缺源于海外头部厂商战略性退出 2D NAND、产能向 HBM 等高端产品倾斜，公司判断供需失衡中短期内仍将存在。在这一较长的供

	给缺口窗口内，以中国大陆和中国台湾为主体的 SLC NAND 产能逐步提升是行业必然，因此不排除以中国大陆企业为主的新进入者出现。 但 SLC NAND 并非单纯的价格驱动型产品，下游工控、车规、通信客户对可靠性、耐久性及供应连续性具有刚性要求，切换供应商的验证周期长、隐性成本高。公司的优势在于：2xnm 制程工艺成熟稳定、1xnm 已实现量产，具备持续迭代能力；车规 SLC NAND、NOR 及 MCP 已通过 AEC-Q100 验证，并进入多家整车厂白名单，在多款车型中规模量产，构成新进入者短期内难以复制的准入壁垒；同时公司是国内少数可同时提供 NAND、NOR、DRAM 完整解决方案的厂商，与核心客户绑定较深，供应链方面与核心供应商建立了长期稳定的战略合作关系。公司有信心凭借上述壁垒，在本轮行业竞争中积极争取进一步提升市场份额。 **3：晶圆成本上涨的传导是否顺利？** 答：尊敬的投资者，您好！2026 年前三季度公司营业收入较上年同期增长 475.03%，第三季度毛利率达 79.31%，较上年同期增加 52.67 个百分点、较上季度增加 4.82 个百分点，存储业务盈利能力稳步回升。公司与国内外多家知名晶圆代工厂和封测厂建立了互助、互利、互信的长期战略合作关系，构建了“本土深度、全球广度”的供应链网络；下游客户端方面，虽然不同类型客户应对周期的节奏有所差异，但公司基于与供应商以及客户的长期稳定合作，努力保持较长周期的稳定盈利水平。但存储行业具有周期性，未来市场供需、产品价格及成本仍存在一定的不确定性。公司将从自身出发，继续推进技术研发，扩充产品料号，优化产品结构，以更好地把握行业上行周期，支撑公司长期稳健发展。提醒各位投资者注意投资风险。 **4：下游需求是否有新增的情况？** 答：尊敬的投资者，您好。关于下游需求，公司看到结构性新增与容量升级并存的积极变化。一方面，AI 由云端训练向端侧推理延伸，公司存储产品凭借高可靠性与低功耗特性，已在智能端侧场景实现应用导入。另一方面，网络通信领域因迭代升级、FTTR 渗透，以及可穿戴设备与物联网模块的功能迭代，持续推动存储容量需求上行。同时需审慎提示，存储价格上行对部分价格敏感型应用的需求节奏可能产生阶段性影响，行业层面亦关注到涨价对部分下游需求的抑制效应。整体而言，利基型存储下游需求稳中有升，但品类与客户结构上存在分化。感谢您对公司的关注。
日期	**2026年11月10日**